证券代码：688183　　证券简称：生益电子

生益电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-006

投资者关系活动类别	☐特定对象调研　☐分析师会议 ☐媒体采访　☐业绩说明会 ☐新闻发布会　☐路演活动 ☐现场参观　☑其他
参与单位名称或人员姓名	Coatue、泰康资产、华商基金、招商基金、瓴仁资产、国金证券、中信建投、工银瑞信基金、嘉实基金、兴全基金、广发基金、point72、富国基金、大成基金、华创证券、中庚基金、汇安基金、中欧基金、浙商证券 **本次投资者关系活动采取现场会议形式，现场调研机构均签署调研承诺函。在交流活动中，我司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。**
时间	2026年11月12日、2026年11月13日
地点	生益电子会议室现场会议
上市公司接待人员	1、董事会秘书：林江 2、财务总监：黄乾初 3、市场部负责人：黄炜
投资者关系活动主要内容介绍	**一、介绍公司基本情况** 董事会秘书简要介绍公司基本情况，包括公司基本经营情况、主要产品应用领域、主要财务情况等内容。 **二、互动交流的主要问题** **1、公司2026年第三季度业绩情况** 公司2026年第三季度实现营业收入37.64亿元，比上年同期增长23.00%；实现归属于上市公司股东的净利润8.01亿元，比上年同期增长37.10%；基本每股收益为0.96元，比上年同期增长35.21%。公司2026年前三季度实现营业收入95.48亿元，比上年同期增长39.81%；实现归属于上市公司股东的净利润19.12亿元，比上年同期增长71.49%；基本每股收益为2.31元，比上年同期增长69.85%。2026年第三季度毛利率36.65%，同比增加2.72个百分点；2026年前三季度毛利率35.23%，同比增加3.25个百分点。 **2、AI PCB 行业景气度以及行业发展趋势** 随着人工智能算力建设持续落地、全球云厂商资本开支稳步提升，数

投资者关系活动主要内容介绍	据中心基础设施建设加速推进，AI服务器与高速交换机成为拉动PCB行业增长的核心引擎，高速互联赛道持续景气。SerDes信号传输速率由56G、112G向224G快速迭代，伴随AI服务器、高速交换机的速率快速提升，高速基板（UBB）、高速背板、高速子卡（OAM）、1.6T交换机、1.6T光模块等产品的高端PCB需求持续上行。PCB已经不再是单纯的电路连接载体，而是保障高速信号完整性、支撑算力稳定释放的关键核心部件，围绕算力设备的PCB产品不断升级。 根据Prismark统计，2026年预计各类PCB产品出货规模有望全线实现增长。其中受益于全球AI基础设施（包含服务器设备、存储设备、AI加速卡等）市场规模正快速扩张，由此带动的AI服务器等高算力设备出货量迅速提高。根据Prismark数据，预计2029年全球服务器/数据存储领域PCB产值规模将达到225.46亿美元，2024年-2029年将以15.6%的复合增长领跑PCB其他应用领域。 AI数据中心的快速扩张亦相应带动高端交换机和高速光模块等高速网络基础设施的需求增长，根据Prismark数据，预计到2029年，全球通信设备领域PCB产值将达到151.55亿美元，2024-2029年将保持平均每年10.2%的复合增长。 未来公司对PCB行业的发展保持信心，将通过深耕服务器和通信网络等市场，紧抓本轮行业高景气机遇。 **3、公司技术研发进展情况** 公司围绕AI算力基础设施PCB核心主线，持续推进下一代超高多层高速板、高阶HDI等产品研发，加大背钻、高速材料配套等核心工艺投入，并积极对接下游客户技术迭代路线开展同步研发，加快推进高速率交换机配套PCB、人工智能计算HDI、卫星通信等前沿领域产品的产业化进程，为新质生产力领域产品供给筑牢技术底座。2026年前三季度，公司研发费用4.59亿元，同比增长40.37%，同时，公司紧抓行业机遇，依托与核心客户的深度战略合作及优质的交付能力，AI服务器、800G/1.6T交换机等数据中心相关产品订单稳步增长，1.6T光模块产品获得突破性进展，卫星通信等新兴领域产业化落地有序推进。 **4、公司产能规划与进展情况** 按产能设计，公司现有产能为246万平方米，同时有多个扩产项目在建，合计在建产能159.21万平方米。东莞人工智能计算HDI生产基地建设项

投资者关系活动主要内容介绍	目、吉安智能制造高多层算力电路板项目、吉安“芯算智联”高速互联电路板制造项目、泰国工厂大算力高端电路板项目等新项目建设有序推进。公司结合下游订单、客户认证节奏有序释放产能，不断提升高端产能供给能力，为公司高质量可持续发展筑牢坚实基础。 具体来看，东莞人工智能计算HDI生产基地建设项目处于土建基础施工阶段，原计划2028年试生产，公司正全力加快项目建设，争取2026年年底前厂房封顶，推进厂房提前投入使用；吉安智能制造高多层算力电路板项目第一阶段已于2026年6月试生产，第二阶段力争提前至2026年底前投入试生产；吉安“芯算智联”高速互联电路板制造项目已于2026年9月下旬正式动工，整体建设期为36个月，目前正按计划有序推进，公司将结合下游客户认证节奏与订单情况，在建设期内分阶段释放产能；泰国工厂一期已进入试生产阶段。 **5、公司下游客户开发的情况** 公司秉承“市场引领，双轮驱动”的发展战略，不断与服务器/计算机、通信网络、汽车电子等下游领域知名客户持续积极接触或建立合作关系。目前公司客户储备丰富，且主要客户均为下游行业的头部企业，已涵盖众多境内外头部AI客户，同时公司也持续推进新客户的认证和开发工作，新客户认证进度良好。 **6、原材料价格增长对公司业绩的影响** 2025年第4季度起，受铜价等外部因素以及上游供应商产能受限等影响，原材料价格出现上涨，本轮原材料涨价属于行业共同面对的现状，原材料的涨价带动产业链各个环节价值传导。同时公司通过持续强化内控管理，进一步升级产品结构及提升质量管理水平，促进了公司业绩增长。2026年第三季度，公司毛利率实现同比和环比增长。 后续公司将持续关注主要原材料以及大宗商品等的价格走势，及时分析市场供需变化，并根据订单情况、库存情况以及原材料和大宗商品价格波动预测，动态调整公司的供应策略，将原材料价格增长对公司业绩影响降低。 **7、公司与控股股东生益科技的交易情况** 生益科技为公司控股股东，也是公司原材料覆铜板的供应商之一。公司一直保持自主管理、独立经营。生益科技作为公司的关联方，双方之间的交易严格遵循市场定价原则，价格结算公平、公允、合理，符合关联交

	易的相关管理规定，确保符合全体股东的利益。 **注：公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。**
附件清单（如有）	无
日期	2026年11月13日